

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2005年6月9日 (09.06.2005)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2005/051652 A1

(51)国際特許分類: B32B 15/08, H05K 3/06, 3/24 (74)代理人: 阿仁屋節雄, 外(ANIYA, Setuo et al.); 〒1020072 東京都千代田区飯田橋4丁目6番1号21東和ビル3階 Tokyo (JP).

(21)国際出願番号: PCT/JP2004/017470

(22)国際出願日: 2004年11月25日 (25.11.2004)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:  
特願2003-395447  
2003年11月26日 (26.11.2003) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 同和  
鉱業株式会社 (DOWA MINING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒  
1008282 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 Tokyo  
(JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 小早志秀一  
(KOHAYASHI, Shuichi) [JP/JP]; 〒1008282 東京都千  
代田区丸の内1丁目8番2号 同和鉱業株式会社  
内 Tokyo (JP). 沢辺 明朗 (SAWABE, Akiro) [JP/JP]; 〒  
1008282 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 同和  
鉱業株式会社内 Tokyo (JP). 北村 征寛 (KITAMURA,  
Yukihiro) [JP/JP]; 〒1008282 東京都千代田区丸の内  
1丁目8番2号 同和鉱業株式会社内 Tokyo (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,  
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,  
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,  
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,  
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,  
IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI  
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,  
SN, TD, TG).

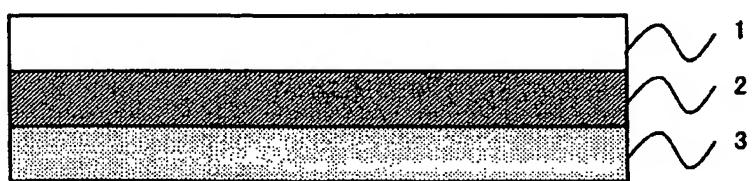
添付公開書類:

— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54)Title: METAL-CLAD SUBSTRATE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54)発明の名称: 金属被覆基板及びその製造方法



tic plastic film layer (2) by a vapor phase method.

(57)Abstract: Disclosed is a metal-clad substrate wherein adhesion strength and adhesion stability between a metal and a plastic film are greatly improved. A multilayer plastic film is obtained by superposing a thermoplastic plastic film layer (2) on a base plastic film layer (3). Then, while controlling the temperature of the thus-formed multilayer plastic film, a metal layer (1) is formed on the thermoplastic plastic film layer (2) by a vapor phase method.

WO 2005/051652 A1

(57)要約: 金属とプラスチックフィルムの密着強度及び安定性の大幅な向上を図る。 基体プラスチックフィルム層3の上に熱可塑性プラスチックフィルム層2を積層して積層プラスチックフィルムとし、この積層プラスチックフィルムの温度を制御しながら、金属層1を気相法により該熱可塑性プラスチックフィルム層2上へ成膜した。